

拒絶理由通知書



特許出願の番号 特願2001-335413
起案日 平成16年 2月12日
特許庁審査官 酒井 英夫 9631 4R00
特許出願人代理人 伊東 忠彦 様
適用条文 第29条第2項

<<<< 最 後 >>>>

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

提出期限

4/19(月)

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の記事に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(1) 請求項11に係る発明に対して

・引用文献: 1-3

引用文献1には、Cuのメッキによって形成された柱状金属部材を有する薄膜多層配線板が記載されている(特に、第2図及び第4頁左下欄参照)。引用文献2及び3にも同様な多層配線板が記載されている。多層配線板内にキャパシタ等の受動素子を内蔵することは、本願出願前の慣用技術にすぎない。

(2) 請求項12に係る発明に対して

・引用文献: 1-4

引用文献1-3いずれかに記載の発明に対し、引用文献4に示された如くの回路基板の表裏導通をボンディングワイヤにより行う技術を採用することは、当業者であれば適宜になし得たものである。

1. 特開平03-246993号公報
2. 特開平05-259639号公報
3. 特開2001-036236号公報
4. 特開平07-321490号公報

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

最後の拒絶理由通知とする理由

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。

なお、この拒絶理由に対し補正をされるのであれば、その際の補正で付加できる事項は、この出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項のほか、出願当初の明細書又は図面の記載から自明な事項に限られ、且つ特許請求の範囲の限定的減縮、不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的とする補正に限られることに注意されたい。また、意見書にて、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書の記載箇所を明確に示したうえで主張されたい。

この拒絶理由通知書についてのお問い合わせ先

特許審査第三部 電子素材加工 審査官 酒井 英夫

電 話 03-3581-1101 (内線3471)

FAX 03-3580-6905